**\_\_ 年 專題實務 \_\_\_\_月 自評表
(至少2個月撰寫一次)**

1. 請描述此期間專題實作進行內容。(內容可包含**所運用的過去學科知識**、**使用相關軟硬體資源**、**軟硬體設計方法**、**創意發想**、**技術突破**、**所遭遇困難與解決方案**等，可外加圖解說明。)

1. 請勾選此期間專題實作所參與的團隊討論、口頭報告、書面報告等活動次數。

🞎 1~2次 🞎 3~4次 🞎 5~6次 🞎 超過 6 次

1. 請勾選此期間專題實作蒐集相關國內外文獻(含專業倫理、智慧財產權)、相關國內外產業趨勢等次數。

🞎 1~2次 🞎 3~4次 🞎 5~6次 🞎 超過 6 次

自評人(簽章) 指導教授(簽章)